

## 光控华登基金完成「盛合晶微」半导体公司投资

2021年10月9日，光大控股（165.HK）宣布旗下光控华登基金完成对领先的中段硅片制造和三维多芯片集成加工企业盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Co.）的C轮投资，共同参与增资的投资人包括建信股权、建信信托、国方资本、碧桂园创投、华泰国际、金浦国调等，既有投资人元禾厚望、中金资本、元禾璞华也参与了本次增资。增资完成后，公司投后估值超过10亿美元。盛合晶微是光大控股在先进半导体领域布局的又一关键核心节点企业。



先进半导体是光大控股重点布局的产业方向之一。在此方向上，光大控股先后布局了光控精技（03302.HK）和上海微电子等“先进半导体装备制造”企业，同时通过光控华登基金布局了ASR、Indie等“先进半导体设计”企业。本次通过投资盛合晶微实现了在“先进半导体封装”领域的布局，进一步完善了光大控股在半导体领域的产业链布局。

光控华登基金表示，“先进半导体是基金积极践行光大控股新科技投资战略的重要布局领域，以投资助力中国半导体产业升级发展。盛合晶微作为我国芯片先进封装领域的龙头企业，公司产品和服务将为我国智慧视觉、智慧物联网、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端和数据中心等多个领域提供核心支撑”。



盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于 12 英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以 3DIC 多芯片集成封装为发展方向的企业。公司在 2016 年即开始提供与 28 纳米及 14 纳米智能手机 AP 芯片配套的高密度凸块加工和测试服务，是大陆第一家提供高端 DRAM 芯片和 12 英寸电源管理芯片凸块加工服务的企业。公司开发的 SmartPoser™ 三维多芯片集成加工技术平台，在 5G 毫米波天线封装领域展现了性能和制造方面的优势，正在为越来越多的新兴应用领域所认可。

目前，盛合晶微在先进封装行业的技术研发实力、业务拓展能力、行业竞争地位和盈利能力等方面均处于行业领先地位。“先进封装”行业市场前景广阔，2019 年全球先进封装市场规模 290 亿美元，预计 2025 年增长到 420 亿美元。中国先进封装市场增长更为显著，预计年均复合增速显著高于全球增速。

此次光大控股对盛合晶微的 C 轮投资由旗下光控华登基金执行，光控华登基金是光大控股科技投资基金部和全球领先的半导体投资机构华登国际共同组建的合作平台。目前光控华登已发起设立一期、二期美元基金和包括盛合晶微在内的两支专项基金，重点关注中国和全球先进半导体领域的股权投资，目前已有项目陆续退出，获得了丰厚的投资回报。